

澜起科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券简称：澜起科技

证券代码：688008

编号：2024-020

|               |  |
|---------------|--|
| 投资者关系活动类别     | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访<br><input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他   |
| 参与单位名称        | 诺安基金管理有限公司<br>华宝基金管理有限公司<br>平安资产管理有限公司<br>民生证券股份有限公司<br>中信证券股份有限公司<br>招商证券股份有限公司<br>淡水泉(北京)投资管理有限公司<br>Platinum Asset Management Ltd<br>2024年半年度业绩说明会线上投资者   |
| 时间            | 2024年9月24~25日、9月27日  |
| 地点            | 公司会议室。公司于9月27日召开的2024年半年度业绩说明会在上证路演中心网站（ <a href="http://roadshow.sseinfo.com/">http://roadshow.sseinfo.com/</a> ）举办。  |
| 出席人员          | 公司董事长兼CEO杨崇和博士、董事兼总经理Stephen Tai先生、独立董事程玉华先生、副总经理兼财务负责人苏琳女士、董事会秘书傅晓女士参加2024年半年度业绩说明会，傅晓女士等参加其他投资者交流活动。   |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p><b>一、交流的主要问题及答复</b></p> <p><b>问题 1：MRDIMM 是内存行业的新产品和新技术，请问该项技术在未来的应用前景如何？</b></p> <p><b>答复：</b>MRDIMM 的主要技术特点和优势包括：一是性能优势，MRDIMM 可以同时访问内存模组上的两个阵列，提供双倍带宽，能够满足服务器 CPU 多核趋势下各个内核的数据吞吐要求，相关测试结果显示，MRDIMM 在 AI、高性能计算等对内存带宽有较高需求的领域，对服务器系统的性能提升明显；二是生态兼容性优势，MRDIMM 与 RDIMM 兼容，可搭配标准 DDR5 DIMM 组件，包括 DRAM、DIMM 外形尺寸和引脚分布、SPD、PMIC 和 TS 等，使得客户可以灵活配置。</p> <p>业内知名内存模组厂商认为：MRDIMM 能够显著提升 AI 推理、模型再训练的效率，并深刻优化当前高性能计算领域的工作负载，其与 DDR5 良好的兼容</p> |

性、即插即用的创新设计，使得客户能够无缝提升内存带宽，未来有望成为推动 AI 与高性能计算发展的重要驱动力

**问题 2：目前 CXL 在内存扩展、内存池化中应用的进度如何，MXC 芯片的用量大致是怎样的？公司如何看待 CXL 这项技术未来的前景，以及和其他互连技术路线的竞争？**

**回复：**目前已有一些服务器厂商推出了内存扩展、内存池化的原型机，根据相关原型机的系统架构，一台用于内存池化的服务器可以配 16 颗 MXC，可以为多个计算节点提供内存池服务。

CXL 技术与其他互连技术各有侧重点，在服务器系统中将各自发挥重要的作用。CXL 主要是解决主机内存与其他设备内存之间一致性及互访的问题。作为一个开放协议，其兼容 PCIe 并采用其物理层来充分利用其庞大的 PCIe 生态，实现对广泛主机设备的支撑。

根据相关行业分析，随着 AI 大模型应用逐步落地，推理将占据绝大部分的智算算力，成本对于 AI 商业模式是否可持续愈加重要，CXL 作为主机与设备间互连的地位将更加巩固和聚焦。基于成本的考虑，如果单纯依赖 GPU 上的 HBM 或者 GDDR 来保存数据，AI 系统会变得非常昂贵，而利用 CXL 接口的内存扩展，可提供低成本、高性能的超大内存池，其 CXL/PCIe 接口可以同时满足 CPU 和 GPU 的访存模式，助力未来的 AI 服务器降低成本，提高效率。

**问题 3：公司 DDR5 内存接口芯片下半年整体渗透率的预计，以及 DDR5 内存接口芯片各个子代下半年迭代进度的预计，这些因素又对公司有什么影响？**

**回复：**自今年年初以来，公司内存接口及模组配套芯片需求实现恢复性增长，DDR5 下游渗透率提升且 DDR5 子代迭代持续推进。从 DDR5 整体渗透率来看，预计 DDR5 内存接口芯片出货量将在今年第三季度超过 DDR4 内存接口芯片。从 DDR5 子代迭代进度来看，今年上半年公司 DDR5 第二子代 RCD 芯片出货量已超过第一子代 RCD 芯片，预计第三子代 RCD 芯片将从今年下半年开始规模出货。DDR5 渗透率的提升以及子代持续迭代有助于相关产品维系平均销售价格及毛利率。

**问题 4：公司今年以来 AI 高性能“运力”芯片新产品的进展情况？**

**答复：**经过前期战略布局和持续的研发投入，公司的三款 AI 高性能“运力”新产品从今年上半年陆续开始规模出货。

1、PCIe Retimer 芯片：受益于全球 AI 服务器需求旺盛以及公司市场份额提升，公司的 PCIe Retimer 芯片出货量快速增长，继 2024 年第一季度出货约 15 万颗之后，第二季度出货约 30 万颗；根据截至 2024 年 7 月 22 日公司订单情况，预计第三季度交付的 PCIe Retimer 芯片在手订单数量约为 60 万颗，环比进一步大幅成长。

2、MRCD/MDB 芯片：受益于 AI 及高性能计算对更高带宽内存模组需求的推动，搭配澜起 MRCD/MDB 芯片的服务器高带宽内存模组开始在境内外主流云计算/互联网厂商规模试用，公司的 MRCD/MDB 芯片销售收入快速增长，继 2024 年第一季度销售收入首次超过 2,000 万元人民币之后，第二季度销售收入超过 5,000 万元人民币，实现翻倍以上增长。

3、CKD 芯片：2024 年 4 月，公司的 CKD 芯片在业界率先试产。受益于 AI PC 产业趋势的推动，以及客户端新 CPU 平台（支持内存速率为 6400MT/S）发布时间临近，相关内存模组厂商开始批量采购 CKD 芯片用于备货，2024 年第二季度公司的 CKD 芯片开始规模出货，单季度销售收入首次超过 1,000 万元人民币。

**问题 5：MRCD/MDB 的产业进度如何，公司在这个产品上有哪些优势？**

**答复：**今年 MRCD/MDB 芯片的需求主要来源于行业规模试用，尚未开始在下游规模应用。

随着支持高带宽内存模组的服务器 CPU 平台发布并上市，将带动 MRCD/MDB 芯片需求的增长，该产品预计从明年开始在下游规模应用。由于一根高带宽内存模组标配 1 颗 MRCD 及 10 颗 MDB 芯片，因此公司在该模组上可提供的芯片价值量较传统 RDIMM 显著增加（传统 RDIMM 搭配 1 颗 RCD 芯片），MRCD/MDB 芯片将为公司带来新的成长空间。根据公开信息及客户反馈，目前全球可以提供 DDR5 第一子代 MRCD/MDB 芯片（支持速率为 8800MT/S）的供应商为两家。澜起牵头制定 MDB 芯片国际标准，研发实力行业领先，多个技术指标（如功耗）较竞争对手具有优势。

**问题 6：公司 PCIe Retimer 芯片前三季度快速增长，想请教下这款产品未来的成长性如何？**

**回复：**PCIe Retimer 芯片将在未来几年为公司贡献新的业绩增长点，增长因素主要包括以下三个方面：

1、AI 服务器需求增加。一台典型的配置 8 块 GPU 的主流 AI 服务器需要 8 至 16 颗 PCIe Retimer 芯片。未来，PCIe Retimer 芯片的市场空间将随着 AI 服务器需求量的增加而持续扩大。

2、市场份额提升。由于澜起自研该产品核心底层技术 SerDes IP，因此在产品时延、信道适应能力等方面具有竞争优势，澜起的 PCIe Retimer 芯片正在获得越来越多客户及下游用户的认可，成长态势良好。

3、PCIe 5.0 生态逐步渗透。PCIe Retimer 芯片是未来数据中心领域重要的互连芯片，可用于 CPU 与 GPU、NVMe SSD、Riser 卡等典型高速外设的互连。目前行业正在由 PCIe 4.0 向 PCIe 5.0 迁移，传输速率从 PCIe 4.0 的 16GT/s 翻倍至 PCIe 5.0 的 32GT/S，未来 PCIe 协议还将升级迭代至 PCIe 6.0、PCIe 7.0，传输速率进一步提升，需要用到 PCIe Retimer 芯片的场景会越来越多。

目前，全球实现量产并出货 PCIe 5.0 Retimer 芯片的供应商主要是两家，澜起的 PCIe Retimer 芯片市占率正显著提升。

**问题 7：我们看到公司新产品时钟发生器芯片已经可以供货了，想请教下这颗芯片的应用领域与公司之前产品有什么差别，未来潜在的市场空间，公司对这个产品未来更长期的布局是怎样的？**

**答复：**今年上半年，公司完成了时钟发生器芯片（Clock Generator）量产版本的研发，目前处于量产前准备阶段。公司已推出首批可编程时钟发生器芯片系列产品，主要针对存储、算力芯片、交换机等应用场景对高性能时钟的需求。



从市场规模来看, 时钟芯片是一个相对成熟、空间较大的市场。根据 Market Data Forecast 的数据, 2022 年全球时钟芯片的市场规模合计为 20.3 亿美元, 预计到 2027 年可达到 30.2 亿美元。

时钟芯片是为电子系统提供其必要的时钟脉冲的芯片, 主要包括时钟发生器芯片、时钟缓冲芯片和去抖时钟芯片。在完成首批时钟发生器芯片量产的同时, 公司已正式启动时钟缓冲芯片 (Clock Buffer) 的研发。公司将进一步完善时钟芯片的布局, 持续丰富相关产品料号, 希望能在不久的将来为客户提供完整的时钟芯片“一站式”解决方案。

**问题 8:** 近期公司推出了第三届董事会核心高管激励计划, 相关考核指标也有一定的挑战性, 特别是市值指标, 我们也都知道市值一般都会存在波动, 存在一定不确定性, 也想问下公司基于哪些因素考量设置这些指标?

**答复:** 2024 年 9 月 3 日, 公司披露了《第三届董事会核心高管激励计划》。本激励计划的激励对象为: 公司 CEO 杨崇和先生以及总经理 Stephen Kuong-Io Tai 先生。杨崇和先生和 Stephen Kuong-Io Tai 先生作为公司创始人、第三届董事会聘任的核心高管, 对公司的发展战略、研发方向、经营管理、资本运作等重大事项的决策和执行具有重要影响力, 对他们实施长期激励, 有助于其带领公司向更长远目标发展。

本激励计划主要有以下三个特点: 一是考核公司中期归母净利润, 体现公司未来业绩的成长性, 其中 2027 年归母净利润目标值为 30 亿元, 是公司 2021-2023 年净利润均值的 3.5 倍, 旨在引导管理层关注长期价值, 设定具有挑战性的业绩目标; 二是考核公司中期市值, 体现公司重视股东回报, 其中 2027 年市值目标值为 1000 亿元, 是激励计划公布前 1 个交易日收盘市值的 1.75 倍, 旨在实现管理层利益与股东利益高度挂钩; 三是授予价格折让少, 体现激励和约束的平衡, 授予价格为 46.50 元/股, 是激励计划公布前 1 个交易日收盘价的 93.1%, 旨在鼓励管理层创造价值增量, 以实现股东利益最大化。

公司希望通过本次激励计划, 向市场传递管理层对公司未来业绩增长的信心, 公司将努力提升投资者回报水平, 以实现公司长期投资价值。

**问题 9:** 能否简介一下今年三季度的经营情况?

|                |   |
|----------------|---|
|                | <p><b>答复：</b>有关公司 2024 年第三季度的业绩，敬请关注公司于 2024 年 10 月 31 日发布的三季报。</p> <p><b>问题 10：请问针对储存厂商的 HBM 产品，是否有研发相关的互连芯片产品？</b></p> <p><b>答复：</b>公司目前不涉及 HBM 产品线。公司的内存接口芯片及模组配套芯片用于 DRAM 内存模组。DRAM 内存模组（如 RDIMM、MRDIMM）是服务器主内存方案，与 HBM 的应用场景不同，分别有相对独立的市场空间，二者都将受益于 AI 产业的发展。</p> <p><b>问题 11：如何预期公司互连类芯片产品线未来的毛利率趋势？</b></p> <p><b>答复：</b>随着公司可销售的互连类芯片产品越来越多，互连类芯片产品线毛利率更多体现了多款产品的综合毛利率水平，与公司当期销售的产品结构相关。根据毛利率水平，相关产品分两大类：1、相比互连类芯片产品线毛利率，DDR5 内存接口芯片及高性能运力芯片新产品（MRCD/MDB、PCIe Retimer、CKD、MXC）的毛利率水平更高；2、DDR4 内存接口芯片已进入产品生命周期后期，部分内存模组配套芯片是公司与合作伙伴合作研发的，需要分享一定的产品毛利，因此相关产品毛利率相对较低。</p> <p>随着 DDR5 渗透率持续提升及高性能运力芯片新产品规模出货带来的收入占比提升，互连类芯片产品线毛利率水平未来有望保持在较高水平。</p> |
| 是否涉及应披露重大信息的说明 | 无   |
| 附件清单（如有）       | 无   |